レーザーはんだ付け材料
Laser Soldering Materials

［ディスペンス工法+レーザーはんだ付け］に対応。ハロゲンフリー対応
Compatible with [Dispensing method + laser soldering] corresponding to halogen-free

LSM series
Laser Soldering Materials

開発品
Under Development

【特長】 Features

- レーザーはんだ付けに対応。優れたはんだ付け性を実現
  Corresponding to Laser-soldering. Achive good solderability.
- 新規フラックス技術で、低フラックス飛散、狭フラックス残渣広がりを達成
  New flux technology, Flux scattering less, and narrow spread of flux residue
- ハロゲンフリー対応
  Corresponding to Halogen free

ディスペンス dispensing of solder → はんだ定量供給性 Quantitative supply of solder
＋
レーザーはんだ付け laser soldering → 部分加熱 partial heating

→

手はんだ工程 Hand soldering
↓
自動化＋品質安定化 Stabilization of quality and automation process

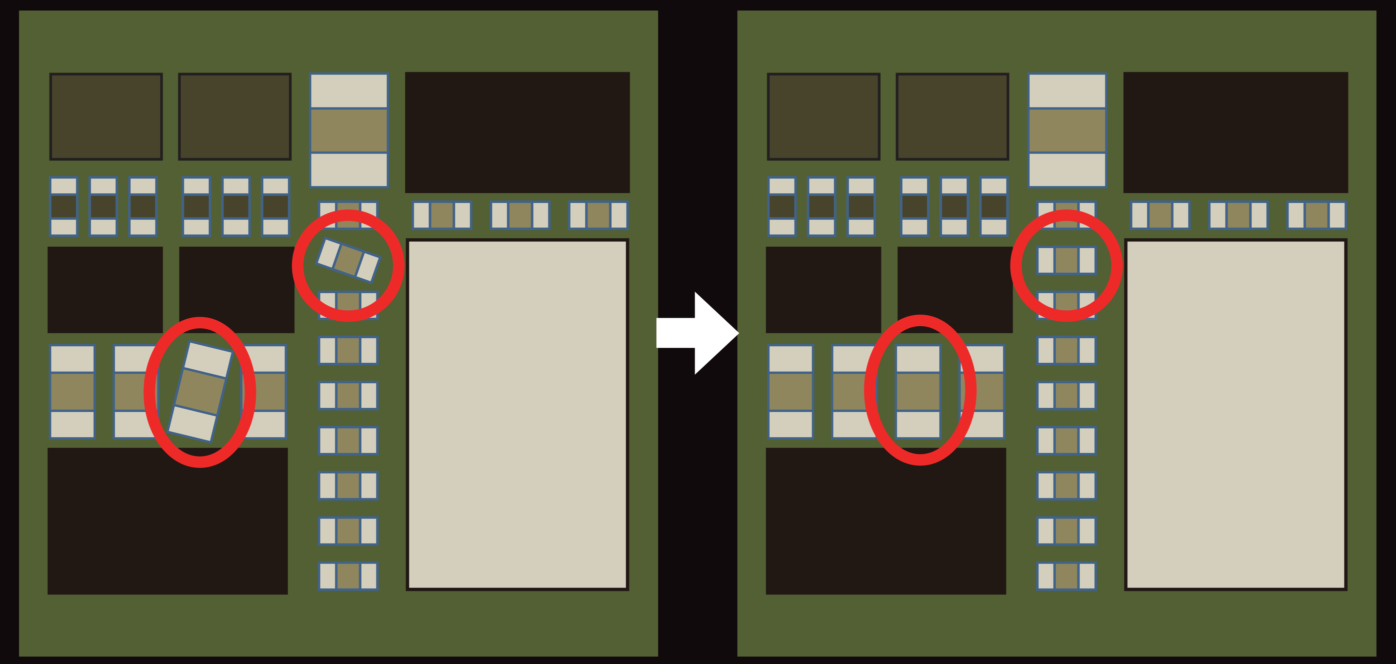
LSM10
LSM10-204-01
良好なレーザー半田付け性
Excellent laser-soldering property
LSM10-204-02TR
ハロゲンフリー
Halogen-free

LSM 主要タイプ
Typical types
Sn-3.0Ag-0.5Cu

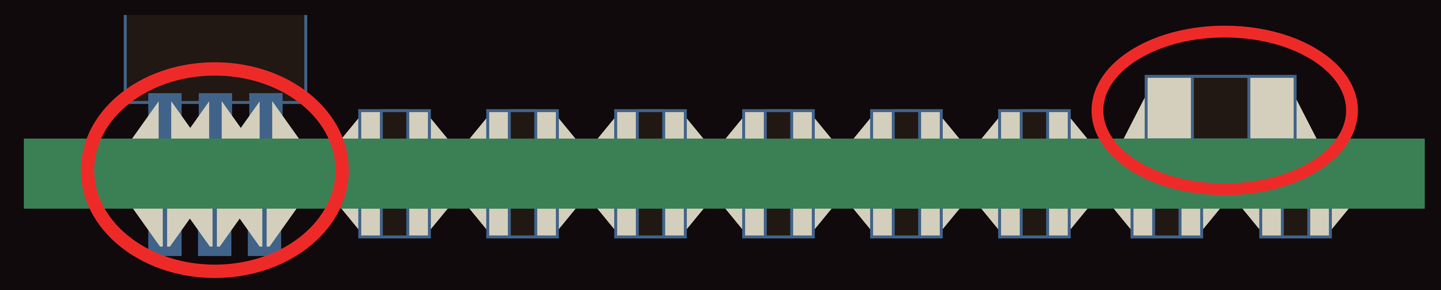
LSM20
LSM20-204-01TR
低フラックス残渣広がり
Narrow spread of flux residue
ハロゲンフリー
Halogen-free

適用例 Application examples

部品位置ずれの修正 Correction of position gap of mounted components



狭ギャップの表面実装基板での、大型部品への追はんだ
Additional solder for large components, in narrow gap surface mount board

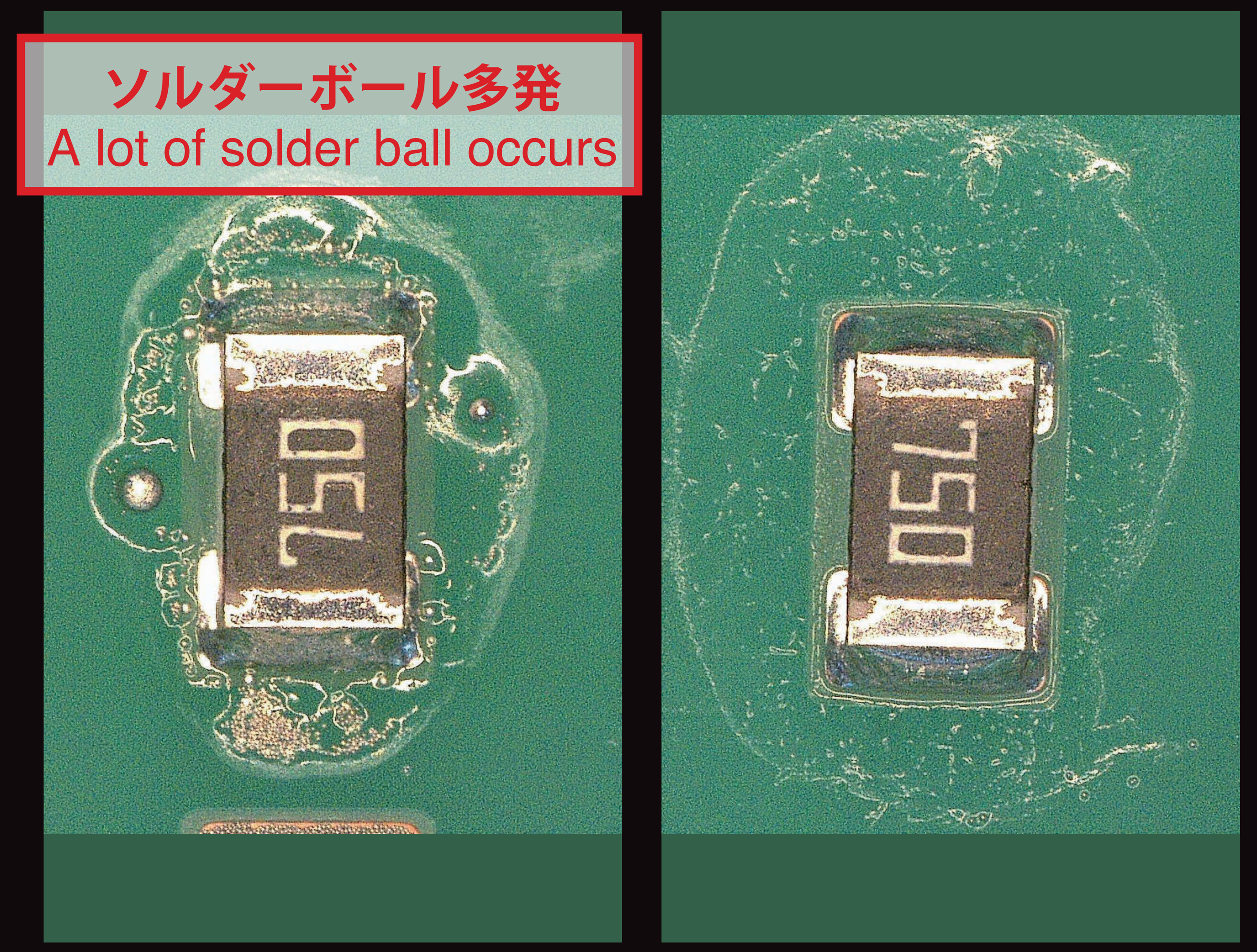


立体形状部へのはんだ付け Soldering to parts of Three-dimensional shape

レーザーはんだ付け実施例 Example laser soldering

通常のソルダーペースト
Conventional Solder Paste

LSM10-204-01

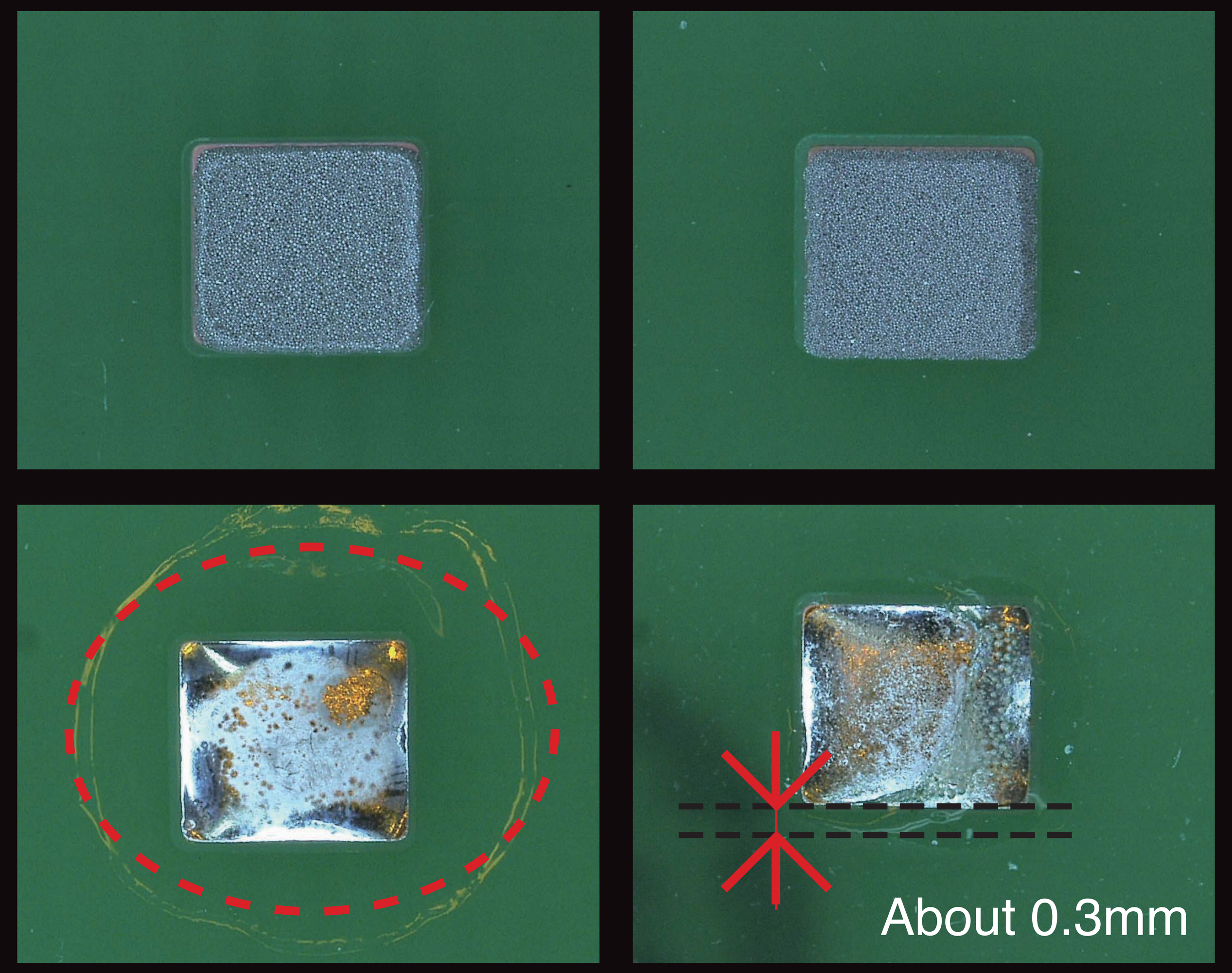


レーザー照射前
Before laser Irradiation

レーザー照射後
After laser Irradiation

通常のソルダーペースト
Conventional Solder Paste

LSM20-204-01TR



TAMURA